

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。随着公司规模不断扩大及业务量的持续增加，公司根据实际经营发展的需要，向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、资产票据池、项目投资建设等，授信期限为 2 年，授信期限内额度可循环使用。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法律文件。

公司与合作的各商业银行皆不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照关联交易决策进行披露，上述交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及担保或关联交易等，应根据担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024年3月15日